

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004年2月19日 (19.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/015763 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/68, 21/66  
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/010166  
 (22) 国際出願日: 2003年8月8日 (08.08.2003)  
 (25) 国際出願の言語: 日本語  
 (26) 国際公開の言語: 日本語  
 (30) 優先権データ:  
 特願2002-234077 2002年8月9日 (09.08.2002) JP  
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社レイテックス (RAYTEX CORPORATION) [JP/JP];  
 〒206-0025 東京都多摩市永山1丁目5番地 Tokyo (JP).  
 (72) 発明者; および  
 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 神野 貴史

(KANNO, Takashi) [JP/JP]; 〒206-0025 東京都多摩市永山1丁目5番地 株式会社レイテックス内 Tokyo (JP). 江口 公博 (EGUCHI, Kimihiro) [JP/JP]; 〒187-0035 東京都小平市小川西町4丁目5番16号 株式会社アムド内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 志賀 正武, 外 (SHIGA, Masatake et al.); 〒104-8453 東京都中央区八重洲2丁目3番1号 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): US.

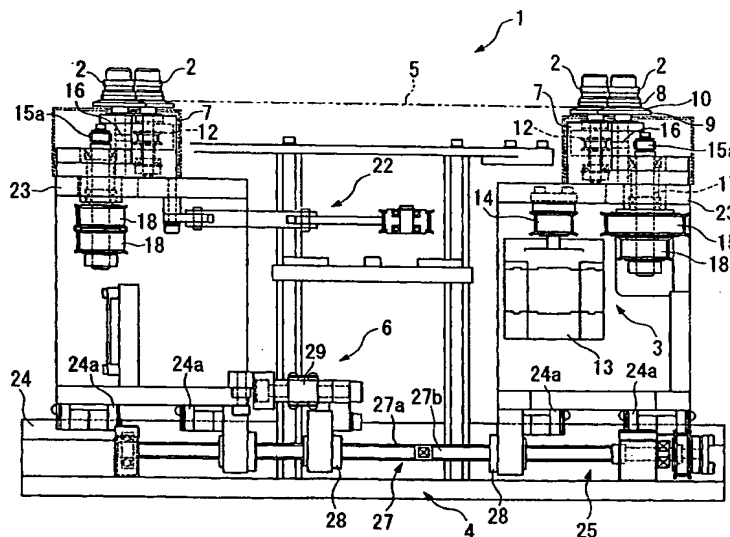
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: WAFER ROTATION DEVICE AND EDGE FLAW INSPECTION APPARATUS HAVING THE DEVICE

(54) 発明の名称: ウエハ回転装置とこれを有する端部傷検査装置



(57) **Abstract:** A wafer rotation device (1) has at least three rollers (2) provided so as to be rotatable about axes arranged in parallel with spacing between them and rotating on a circumferential face of a circular disk-like wafer (5), a rotation drive mechanism (3) for rotating at least one of the rollers (2), a spacing adjustment mechanism (4) capable of adjusting dimensions between the rollers (2), and a load control device (6) for controlling, when the wafer (5) is held by the rollers (2), a load to be applied from the rollers (2) to the wafer (5) in a radial direction of the wafer (5). A silicon wafer is rotated without contact to its front and reverse faces.

(57) 要約: ウエハ回転装置1は、平行間隔をあけて配置された軸線周りに回転可能に設けられ、円板状のウエハ5の円周面上を転がる少なくとも3個のローラ2と、少なくとも1個のローラ2を回転駆動する回転駆動機構3と、前記ローラ2の間隔寸法を調整可能な間隔調整機構4と、前記ローラ2にウエハ5を挟んだときに、ローラ2からウエ

[続葉有]